

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2022-015

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币2.83元（含税），以未分配利润向全体股东每10股送3股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配、送转比例不变，相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于30%，主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段，研发投入、业务规模扩充、营运资金投入等所需资金较大。

一、利润分配和送转预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021全年实现净利润人民币536,077,758.39元，扣除按10%计提盈余公积人民币53,607,775.84元，加上公司以前年度未分配利润人民币1,079,951,299.64元，减去支付2020年度应付股利人民币79,915,221.45元，减去2020年度未分配利润送股34,006,476元，期末可供分配利润为人民币1,448,499,584.74元，期末母公司资本公积为1,826,189,922.69元。

公司2021年度利润分配预案为：以公司目前总股本408,077,716股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本

由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.83 元（含税），共计人民币 115,485,993.63 元，同时以未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计送、转股 244,846,630 股，送转股后公司总股本为 652,924,346 股。

二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用领域，随着 5G、AI、算力算法的趋势性发展与提升，以摄像头为代表的传感器产品应用场景越来越丰富，推动手机多摄像头应用渗透率持续提升、安防监控数码市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应用快速兴起，使得公司所专注的光学传感器细分市场持续快速增长。作为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头，2021 年度公司的营业收入、净利润规模保持持续快速增长，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告（容诚审字[2022]230Z0799 号），2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 576,048,107.03 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 471,297,051.29 元，较 2020 年同比分别增长了 50.95%、43.24%，公司业务与盈利能力快速成长。2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 576,048,107.03 元，2021 年拟分配的现金红利总额为 115,485,993.63 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要基于以下因素：

1、公司所处行业情况及特点

公司属于集成电路产业中的封装测试行业，所处行业具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的行业特征。生产所需的机器设备等资本投入规模较大，人力与智力投入大，产业技术创新日新月异，市场需求变化步伐快，需要企业专注

主业，通过持续技术创新，加大资本投入、构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

2、公司发展阶段

公司目前处于扩张成长阶段。公司主要专注于集成电路传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。随着 5G、AI、算力算法的趋势性发展与提升，以摄像头为代表的传感器产品应用场景越来越丰富，推动手机多摄像头应用渗透率持续提升、安防监控数码市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应用快速兴起，公司封装产品的行业与市场景气度显著提升。为抓住传感器领域的市场机遇，公司正在实施“集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目”的建设，通过技术工艺升级提升，产能扩充，满足市场与客户的创新需求，该项目的有序建设，推动公司有效把握了手机、安防监控数码市场快速发展机遇，并在汽车电子领域实现了量产，后续将根据市场的增长情况，对工艺与产能进行持续的布局与提升。

3、公司近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2021 年	3	2.83	3	115,485,993.63	576,048,107.03	20.05
2020 年	1	2.35	1	79,746,019.54	381,616,747.13	20.90
2019 年	2	1.00	2	22,967,945.5	108,304,952.46	21.21

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均超过 20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%”的规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

4、公司未分配利润的主要用途

公司未分配利润的用途将主要用于产业链的延伸拓展、加大公司研发投入以及营运资金等方面。

(1) 产业链延伸拓展。持续开展国际化并购整合，推进产业链的延伸拓展。2021 年公司收购晶方产业基金股权，实现对晶方光电及荷兰 Anteryon 的股权控制，进一步加强业务与技术的互补融合，一方面推进 Anteryon 公司的光学设计与混合光学镜头业务的稳步增长，盈利能力不断增强。同时有效提升晶方光电晶圆级微型光学器件制造技术的工艺、量产能力，开始实现商业化规模应用。参与投资以色列 VisIC 公司，积极布局车用高功率氮化镓技术，充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，为把握三代半导体在新能源汽车领域的产业发展机遇进行技术与产业布局。参与共建“苏州市产业技术研究院车规半导体产业技术研究所”，充分利用政府、产研院等共建方的资源支持，通过引入、孵化与培育研发团队，对车规半导体新工艺、新材料、新设备展开研发与战略布局，以车电半导体需求为聚焦点构建产业生态链，以期能更好把握汽车产业智能化，电动化和网联化带来的新发展机遇。国际化的并购整合与产业链拓展延伸，需要相应的资金储备与能力，才能快速抓住行业出现的新机会。

(2) 持续加强研发投入。公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善。公司成立以来，始终注重技术的研发投入与持续创新，一步步发展为全球传感器领域先进封装技术的引领者，2019 年、2020 年及 2021 年公司的研发费用分别达 123,202,937.94 元、137,260,099.21 元、172,623,162.92 元，2022 年公司仍需保持对研发的持续投入，通过对技术、工艺的持续创新开发，顺应并把握不断变化的市场需求。

(3) 满足业务规模持续增长的营运资金需要。随着公司资产、业务及生产规模的发展，公司的营运资金投入也会相应有所增长。2021 年公司实现营收规模为 1,411,173,857.40 元，同比增长 27.88%，2022 年随着公司在车载摄像头、汽车微型光学器件等应用领域量产规模的提升、募投项目建设及产能规模的不断扩大、生产效率的持续提升，公司业务规模将保持快速增长，从而将使得公司经营

所需营运资金规模也相应会增加。

因此，公司将留存未分配利润用于产业链延伸拓展、研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司 2021 年利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。

2、本次以未分配利润和资本公积金送、转增股本，有利于扩大公司股本规模，促进公司持续稳定发展，不存在损害股东合法权益的情形。

3、本预案符合《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求，审批程序符合法律、法规的要求，不存在损害公司或投资者利益的情形。

同意本次利润分配预案并将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，独立董事发表了同意的独立意见。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日